

证券代码:688630 证券简称:芯基微装 公告编号:2026-007

合肥芯基微电子装备股份有限公司

2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：元、股、元/股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,408,121,260.32	953,942,795.24	47.61
营业利润	330,394,574.37	169,739,705.20	94.65
利润总额	329,717,726.94	171,068,236.36	92.74
归属于母公司所有者的净利润	289,933,018.30	160,695,258.36	80.42
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	276,328,664.07	148,567,777.03	86.00
基本每股收益 (元)	2.20	1.23	78.86

加权平均净资产收益率 (%)	13.28	7.91	增加 5.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	3,116,654,513.00	2,788,843,157.82	11.75
归属于母公司的所有者权益	2,308,371,801.86	2,062,601,576.72	11.92
股本	131,740,716.00	131,740,716.00	0
归属于母公司所有者的每股净资产 (元)	17.52	15.66	11.88

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入 140,812.13 万元，同比增长 47.61%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,993.30 万元，同比增长 80.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,632.87 万元，同比增长 86.00%；基本每股收益为 2.20 元/股，同比增长 78.86%；报告期末，公司总资产 311,665.45 万元，较期初增长 11.75%；归属于母公司的所有者权益为 230,837.18 万元，较期初增长 11.92%。

2025 年度公司经营态势持续向好，实现高质量高速增长，在 PCB 及泛半导体领域的核心竞争力进一步凸显，海外市场拓展、产品升级、产能提升等方面均取得显著成效。报告期内，公司紧密围绕战略方向，持续深化直写光刻技术应用，推进 PCB 高

端 LDI 设备迭代升级，丰富泛半导体产品矩阵，泛半导体领域 WLP 系列设备实现批量交付并助力头部厂商量产。同时，全球化战略落地成效显著，泰国子公司充分发挥区域运营与服务枢纽作用，东南亚市场订单持续向好，海外业务规模大幅增长，产品出口至日本、越南等多个国家和地区，品牌全球影响力与市场占有率进一步提升，前期战略布局逐步进入收获期。

营收方面，全年收入实现跨越式增长，核心业务板块 PCB 业务与泛半导体业务协同发力、多点突破，有效承接行业增量需求。报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益均实现大幅同比增长，各项核心业绩指标均实现大幅攀升，盈利能力显著增强。利润增长幅度高于营收增长幅度，主要得益于高端 PCB 设备订单旺盛、泛半导体业务放量带来的产品结构优化，以及规模效应释放有效摊薄单位运营成本。报告期末，公司总资产及归属于母公司的所有者权益均较期初实现稳步增长，整体财务结构稳健，资产质量优良，为公司后续产能扩张、技术研发及全球化布局奠定了坚实基础。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年2月26日